



BPSDMI
Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



PROGRAM

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

TEKNISI PROSES *MOLDING*

Kode Program Pelatihan

C.60SEM.PROG.12.24

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, bahwa setiap penyusunan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Untuk mengimplementasi Pelatihan Berbasis Kompetensi diperlukan Program Pelatihan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai/Lembaga Pelatihan (*Training Centre*) baik milik Pemerintah maupun Swasta.

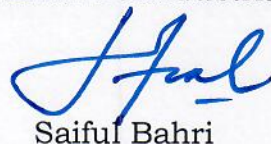
Program Pelatihan "**Teknisi Proses Molding**" mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No 130 Tahun 2024 tentang Bidang Industri Semikonduktor. Pelatihan ini merupakan Program yang dapat dilaksanakan tanpa harus melalui Pelatihan berjenjang terkait.

Program Pelatihan ini disusun oleh *Stakeholders* yang berkompeten di dalam Industri Semikonduktor sehingga seluruh isi dari Program Pelatihan ini dapat sesuai dengan kebutuhan industri terkait. Program pelatihan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan Pelatihan dan menjadi acuan yang sama untuk menyelenggarakan Pelatihan di Bidang Industri Semikonduktor

Demikian program Pelatihan Berbasis Kompetensi ini disusun, semoga dapat digunakan dan bermanfaat dalam menunjang proses pelaksanaan Pelatihan di Balai/Lembaga Pelatihan (*Training Centre*), dalam rangka meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di dalam maupun di luar negeri.

Jakarta, Oktober 2024

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri
Kementerian Perindustrian



Saiful Bahri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. INFORMASI UMUM PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	1
B. KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	3
C. SILABUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	4
KELOMPOK UNIT KOMPETENSI:	4
1.1 Melaksanakan <i>Set Up</i> dan <i>Adjustment Parameter</i> Berdasarkan Spesifikasi Produk pada <i>Transfer Mold Equipment</i>	4
1.2 Melakukan <i>Adjustment Parameter</i> pada <i>Curing Equipment</i>	14
KELOMPOK PENUNJANG (NON UNIT KOMPETENSI)	19
2.1 Etos Kerja	19
2.2 Clean Room Protocol	19
D. DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN	20
E. DAFTAR NAMA BAHAN YANG DIBUTUHKAN	23
F. DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN	25

A. INFORMASI UMUM PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

1.	Judul Program Pelatihan	:	Teknisi Proses <i>Molding</i>
2.	Kode	:	C.60SEM.PROG.12.24
3.	Jenis Program Pelatihan	:	Okupasi
4.	Metode Pelatihan	:	Luring
5.	Tujuan Pelatihan	:	Setelah mengikuti pelatihan ini peserta kompeten dalam menjalankan tugas sebagai teknisi proses <i>Molding</i>
6.	Kemungkinan Jabatan	:	Teknisi Proses <i>Molding</i>
7.	Standar yang digunakan	:	SKKNI No. 130 Tahun 2024
8.	Persyaratan Peserta Pelatihan		
	8.1 Pendidikan	:	1. Minimal SMA atau sederajat; atau 2. Minimal Diploma 3
	8.2 Pelatihan	:	Tidak ada.
	8.3 Pengalaman Kerja	:	1. Minimal 2 tahun di bidang Teknik untuk pendidikan minimal SMA atau sederajat dan/atau Diploma 3 Selain Mesin/Elektro/Mekatronika; 2. Tanpa pengalaman kerja untuk Pendidikan minimal Diploma 3 Mesin/Elektro/Mekatronika
	8.4 Jenis Kelamin	:	Laki-laki/perempuan
	8.5 Umur	:	Minimal 18 tahun
	8.6 Kesehatan	:	Sehat jasmani dan sehat rohani
	8.7 Persyaratan Khusus	:	Tidak buta warna
9.	Persyaratan Instruktur		
	9.1 Pendidikan Formal	:	Diploma 3 Teknik Mesin/Elektro/Mekatronika
	9.2 Kompetensi Metodologi	:	Memiliki sertifikat ToT
	9.3 Kompetensi Teknis	:	Menguasai proses <i>Molding</i>
	9.4 Pengalaman Kerja	:	Minimal 3 tahun di industri Semikonduktor

	9.5 Kesehatan	:	Sehat jasmani dan rohani
	9.6 Persyaratan Khusus	:	Tidak buta warna

B. KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

NO	MATERI PELATIHAN	KODE UNIT KOMPETENSI	PERKIRAAN WAKTU TEORI (JP)	PERKIRAAN WAKTU PRAKTIK (JP)	JUMLAH JAM PELATIHAN (TEORI DAN PRAKTIK)
I	Kelompok Unit Kompetensi				
	1.1 Melaksanakan <i>Set Up dan Adjustment Parameter</i> berdasarkan spesifikasi produk pada <i>Transfer Mold Equipment</i>	C.26SEM03.007.1	56	63	119
	1.2 Melakukan <i>Adjustment Parameter</i> pada <i>Curing Equipment</i>	C.26SEM03.009.1	8	8	16
	Jumlah I		38	58	96
II	Kelompok Penunjang (Non Unit Kompetensi)				
	2.1 Etos Kerja	-	1	0	1
	2.2 Clean Room Protocol	-	1	0	1
	Jumlah II		2	0	2
	Jumlah I & II		66	71	137

C.SILABUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

1. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI

- 1.1 Unit Kompetensi : Melaksanakan Set Up dan Adjustment Parameter Berdasarkan Spesifikasi Produk pada Transfer Mold Equipment
- Kode Unit : C.26SEM03.007.1
- Perkiraan Waktu Pelatihan : 119 JP @ 45 menit
- Metode Pelatihan : Luring
- Capaian Unit Kompetensi : Melakukan *setup* dan *adjustment* parameter berdasarkan *assembly spec* sesuai prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
1. Menyiapkan pelaksanaan <i>set up</i> dan <i>adjustment</i> parameter berdasarkan spesifikasi produk pada <i>transfer mold equipment</i>	1.1 Electro Static Discharge (ESD) dan working attire diidentifikasi. 1.2 Tipe, spesifikasi, karakteristik, fungsi, dari produk semikonduktor diidentifikasi.	Terdokumen tasikan setup check sheet persiapan pengoperasian <i>transfer mold equipment</i> meliputi: <i>tipe material, Mold tool</i>	1.1 Pengetahuan dasar perakitan semikonduktor (terkait KUK 1.1 s.d 1.11) – (10 JP)	1.1 Membaca <i>lot traveller</i> dengan teliti – (2 JP) 1.2 Mampu mengidentifikasi dan melakukan <i>handling</i>	Pengetahuan: 56 JP Keterampilan: 63 JP

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	1.3 Process flow perakitan semikonduktor diidentifikasi. 1.4 Flow chart pada setiap station proses perakitan semikonduktor diidentifikasi. 1.5 Tipe dan spesifikasi dari material perakitan semikonduktor diidentifikasi. 1.6 Set up tools diidentifikasi. 1.7 Format Mold Out of Control Action Plan (OCAP) diidentifikasi. 1.8 Format standart operating procedure diidentifikasi.	ID, <i>Equipment ID</i> , <i>lot traveller</i>	1.2 Proses <i>transfer mold</i> – (8 JP) 1.3 Fungsi, dan bagian-bagian dari <i>transfer mold equipment</i> – (12 JP) 1.4 Prosedur pengoperasian mesin <i>transfer mold</i> (termasuk K3 di KUK 1.33) – (10 JP) 1.5 Metrologi tools – (6 JP) 1.6 Anti <i>mixed device</i>	<i>material (bonded leadframe, magazine)</i> dengan cermat dan teliti – (8 JP)	

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	1.9 Format work instruction diidentifikasi. 1.10 Format lot traveller diidentifikasi. 1.11 Format assembly spec diidentifikasi. 1.12 Mold defect catalogue diidentifikasi. 1.13 Posisi, fungsi, dan persyaratan pengoperasian tombol emergency stop diidentifikasi. 1.14 Jenis, fungsi, prinsip kerja, dan bagian-bagian dari transfer molding equipment diidentifikasi.		<i>procedure</i> – (1 JP)		

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	1.15 Mold transfer equipment identification (ID) diidentifikasi. 1.16 Prosedur setup mold transfer equipment diidentifikasi 1.17 Prosedur adjustment parameter mold transfer equipment diidentifikasi. 1.18 Jenis, bagian-bagian, fungsi, dan cara kerja dari mold tooling diidentifikasi. 1.19 Mold tool ID diidentifikasi 1.20 Prosedur setup mold chase pada mold tool diidentifikasi.				

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	1.21 Prosedur setup plunger position diidentifikasi. 1.22 Prosedur adjustment untuk plunger valve diidentifikasi. 1.23 Prosedur setup untuk pin ejector position diidentifikasi. 1.24 Prosedur adjusment bottom plate equipment opening speed diidentifikasi. 1.25 Prosedur adjustment transfer pressure diidentifikasi. 1.26 Prosedur setup Leadframe loader diidentifikasi				

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	1.27 Prosedur setup pellet loader diidentifikasi 1.28 Mold cleaning type diidentifikasi. 1.29 Mold compound type diidentifikasi. 1.30 Mold compound size diidentifikasi. 1.31 Prosedur pengoperasian mold transfer equipment diidentifikasi . 1.32 Format pelaporan diidentifikasi. 1.33 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diidentifikasi dan diterapkan pada kegiatan ini.				

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
2. Memastikan <i>transfer mold equipment</i> siap dioperasikan	2.1 <i>Assembly spec</i> untuk <i>setup</i> dan <i>adjustment transfer mold equipment</i> dipastikan kesiapannya sesuai prosedur. 2.2 <i>Set up tools</i> untuk <i>mold transfer equipment</i> dipastikan kesiapannya sesuai prosedur. 2.3 <i>Adjustment</i> paramater dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.4 <i>Setup</i> dan <i>adjustment mold tool</i> pada <i>transfer mold equipment</i> dilakukan	Tersedianya <i>transfer mold equipment</i> dengan <i>setup</i> dan <i>adjustment</i> sesuai prosedur	2.1 <i>Bonded Leadframe Orientation</i> – (2 JP) 2.2 <i>Acceptance</i> dan <i>reject criteria</i> – (4 JP) 2.3 <i>Transfer mold</i> OCAP – (2 JP) 2.4 Format pelaporan – (1 JP)	2.1 Mampu mengoperasikan, <i>set up</i> dan <i>assist</i> mesin <i>transfer mold</i> dengan cermat dan teliti – (22 JP) 2.2 Mampu melakukan pengukuran hasil <i>transfer mold</i> dengan cermat dan teliti – (8 JP) 2.3 Mampu mengidentifikasi <i>reject criteria</i> dengan	

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.5 <i>Setup dan adjustment mold chase</i> pada <i>mold tool</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.6 <i>Adjustment plunger position</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.7 <i>Adjustment plunger valve</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.8 <i>Adjustment pin ejector position</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur			cermat dan teliti – (18 JP) 2.4 Mampu melaksanakan prosedur OCAP dengan cermat dan teliti – (4 JP) 2.5 Mampu mengisi laporan dengan disiplin, cermat, teliti – (1 JP)	

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	2.9 <i>Adjustment bottom plate equipment opening speed</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.10 <i>Adjustment transfer pressure</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.11 <i>Setup dan adjustment Leadframe loader</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.12 <i>Setup dan adjustment pellet loader</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur				

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	2.13 Proses <i>transfer mold</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.14 <i>Mold cleaning</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.15 <i>Record</i> proses <i>set up</i> serta <i>adjustment</i> dan hasil <i>transfer mold</i> dilakukan sesuai prosedur.				
Asesmen					

- 1.2 Unit Kompetensi : Melakukan Adjustment Parameter pada Curing Equipment
- Kode Unit : C.26SEM03.009.1
- Perkiraan Waktu Pelatihan : 16 JP @ 45 menit
- Metode Pelatihan : Luring
- Capaian Unit Kompetensi : melakukan *adjustment* paramater berdasarkan *assembly spec* sesuai prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
1. Menyiapkan pelaksanaan <i>adjustment</i> parameter pada <i>curing equipment</i>	1.1 <i>Electro Static Discharge (ESD) dan working attire</i> diidentifikasi.	Terdokumentasi kan <i>setup check sheet</i> persiapan pengoperasian <i>curing equipment</i> meliputi: <i>equipment identification (ID)</i> dan <i>lot number</i>	1.1 Pengetahuan dasar perakitan semikonduktor (terkait KUK 1.1 s.d 1.11) – (0 JP)	1.1 Mampu membaca <i>lot traveller</i> dan <i>buildsheet</i> dengan teliti – (0 JP)	Pengetahuan : 8 JP Keterampilan : 8 JP
	1.2 Tipe, spesifikasi, karakteristik, fungsi, dari produk semikonduktor diidentifikasi.		1.2 Proses <i>curing</i> – (1 JP)	1.2 Mampu mengidentifikasi dan melakukan	
	1.3 <i>Process flow</i> perakitan semikonduktor diidentifikasi.		1.3 Fungsi, dan bagian-bagian dari <i>curing equipment</i> – (1 JP)	<i>handling material</i> dengan	
	1.4 <i>Flow chart</i> pada setiap <i>station</i> proses				

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	perakitan semikonduktor diidentifikasi. 1.5 Tipe dan spesifikasi dari material perakitan semikonduktor diidentifikasi. 1.6 <i>Tools</i> yang akan dipakai diidentifikasi. 1.7 <i>Curing process Out of Control Action Plan</i> (OCAP) diidentifikasi. 1.8 Format <i>standart operating procedure</i> diidentifikasi. 1.9 Format <i>work instruction</i> diidentifikasi. 1.10 Format <i>lot traveller</i> diidentifikasi.		1.4 Anti <i>mixed device procedure</i> – (1 JP) 1.5 Prosedur pengoperasian <i>curing equipment</i> (termasuk K3 di KUK 1.19) – (1 JP)	cermat dan teliti – (2 JP)	

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	1.11 Format <i>assembly spec</i> diidentifikasi. 1.12 <i>Curing defect catalogue</i> diidentifikasi. 1.13 Posisi, fungsi, dan persyaratan pengoperasian tombol <i>emergency stop</i> diidentifikasi. 1.14 Jenis, fungsi, prinsip kerja, dan bagian-bagian dari <i>curing equipment</i> diidentifikasi. 1.15 Nomor <i>identification</i> (ID) dari <i>curing equipment</i> diidentifikasi. 1.16 Prosedur <i>adjustment</i> parameter <i>curing</i>				

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	<i>equipment</i> diidentifikasi. 1.17 Prosedur pengoperasian <i>curing equipment</i> diidentifikasi . 1.18 Format pelaporan diidentifikasi. 1.19 Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diidentifikasi dan diterapkan pada kegiatan ini.				
2. Memastikan <i>curing equipment</i> siap dioperasikan	2.1 <i>Assembly spec</i> untuk <i>adjustment Post Mold Cure equipment</i> dipastikan kesiapannya sesuai prosedur.	Tersedianya <i>curing equipment</i> dengan <i>setup</i> dan <i>adjusted parameter</i> sesuai prosedur	2.1 <i>Curing equipment</i> OCAP – (2 JP) 2.2 Format pelaporan – (1 JP)	2.1 Mampu mengoperasikan, melakukan <i>set up</i> dan <i>assist curing</i>	

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
	2.2 Pemilihan <i>recipe curing</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur. 2.3 <i>Adjustment</i> paramater dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.4 <i>Curing process</i> dilakukan berdasarkan <i>assembly spec</i> sesuai prosedur 2.5 <i>Record</i> proses <i>adjustment</i> dan hasil <i>Post Mold Cure</i> dilakukan sesuai prosedur.			<i>equipment</i> dengan cermat dan teliti – (4 JP) 2.2 Mampu melaksanakan prosedur OCAP dengan cermat dan teliti – (1 JP) 2.3 Mampu mengisi laporan dengan disiplin, cermat, teliti – (1 JP)	
Asesmen					

2 KELOMPOK PENUNJANG (NON UNIT KOMPETENSI)

- 2.1 Non Unit Kompetensi : *8 Pilar Etos Kerja*
Perkiraan Waktu Pelatihan : 1 JP @ 45 Menit

Pokok Pembahasan	Perkiraan Waktu Pelatihan (JP)	
	Pengetahuan	Keterampilan
1. 8 Pilar Etos Kerja	1 JP	0

- 2.2 Non Unit Kompetensi : Clean Room Protocol
Perkiraan Waktu Pelatihan : 1 JP @ 45 Menit

Pokok Pembahasan	Perkiraan Waktu Pelatihan (JP)	
	Pengetahuan	Keterampilan
1. Prosedur <i>clean room</i> (untuk front end 1K ppm; untuk back end 10K ppm)	1 JP	0

D. DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Judul Program PBK : Teknisi Proses *Molding*
Perkiraan Waktu Pelatihan : 137 JP
Metode Pelatihan : Luring

No	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan/ Volume	Keterangan
1.	<i>Tweezer dengan stopper</i>	Menyesuaikan dengan <i>leadframe</i>	1	pc	Per batch pelatihan
2.	<i>Trolley</i>	Standar industri	1	pc	Per batch pelatihan
3.	Rak	Standar industri	1	pc	Per batch pelatihan
4.	Microscope	Pembesaran 10-40 x	1	unit	Per batch pelatihan
5.	Mesin <i>transfer mold</i>	Standar industri	1	unit	Per batch pelatihan
6.	Oven Curing	Suhu maksimal 300 derajat	1	unit	Per batch pelatihan
7.	<i>Magazine FOL</i>	Menyesuaikan dengan <i>leadframe size</i> yang digunakan	1	pc	Per batch pelatihan
8.	<i>Magazine EOL</i>	Menyesuaikan dengan <i>leadframe size</i> yang digunakan	1	pc	Per batch pelatihan
9.	<i>Kunci L</i>	Menyesuaikan dengan mold	1	Set	Per peserta pelatihan

No	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan/ Volume	Keterangan
		<i>tool dan equipment yang digunakan</i>			
10.	<i>Adjustable wrench</i>	Menyesuaikan dengan mold <i>tool dan equipment yang digunakan</i>	5	pcs	Per batch pelatihan
11.	<i>Kunci ring</i>	Menyesuaikan dengan mold <i>tool dan equipment yang digunakan</i>	1	Set	Per peserta pelatihan
12.	<i>Kunci pas</i>	Menyesuaikan dengan mold <i>tool dan equipment yang digunakan</i>	5	set	Per batch pelatihan
13.	<i>Thermometer</i>	Magnetic probe	5	pcs	Per batch pelatihan
14.	<i>Screw driver</i>	Menyesuaikan dengan mold <i>Tool dan equipment yang digunakan</i>	5	set	Per batch pelatihan
15.	<i>Palu kuningan/ brass</i>	5x5 cm	5	pcs	Per batch pelatihan

No	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan/ Volume	Keterangan
16.	<i>Cisel</i> kuningan/ <i>brass</i>	Tebal = 3 mm, Lebar = 15 mm	5	pcs	Per batch pelatihan
17.	<i>Stick</i> kuningan/ <i>brass</i>	Diameter 3 mm	5	pcs	Per batch pelatihan
18.	<i>Inspection mirror</i>	Diameter 3 cm dan <i>telescopic</i>	5	pcs	Per batch pelatihan
19.	<i>Hand lifter</i>	Minimal daya angkut 2 ton	1	unit	Per batch pelatihan
20.	<i>Lint free hand gloves</i>	Heat resistance	1	pair	Per Oven Curing

E. DAFTAR BAHAN YANG DIBUTUHKAN

Judul Program PBK : Teknisi Proses *Molding*

Perkiraan Waktu Pelatihan : 137 JP

Metode Pelatihan : Luring

No	Nama Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan/ Volume	Keterangan
1.	<i>Assembly spec/sop</i>	Hardcopy	1	set	per peserta pelatihan
2.	<i>SOP</i>	Hardcopy	1	Set	Per peserta pelatihan
3.	<i>Lot traveller</i>	Hardcopy	1	set	per peserta pelatihan
4.	<i>Working instruction</i>	Hardcopy	1	set	per peserta pelatihan
5.	<i>Attire:</i> - ESD <i>smock</i> - ESD <i>shoes</i> - ESD <i>wrist strap</i> - ESD <i>lint free gloves</i> - <i>Finger coats</i> - <i>Lint free masker</i>	Standar industri (<i>clean room</i>)	1	set	per peserta pelatihan
6.	<i>Lint free hand gloves</i>	Heat resistance	1	pair	Per Oven Curing
7.	<i>Flow Chart</i>	Hardcopy	1	set	Per batch pelatihan
8.	OCAP	Hardcopy	1	set	Per batch pelatihan
9.	<i>Bare dummy leadframe</i>	Menyesuaikan dengan <i>package</i>	2	Shot	Per batch pelatihan

No	Nama Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan/ Volume	Keterangan
		yang akan di buat			
10.	<i>Bonded dummy leadframe</i>	Menyesuaikan dengan <i>package</i> yang akan di buat	2	Shot	Per batch pelatihan
11.	<i>Marker</i>	<i>Clean Room Standard</i>	1	pc	Per batch pelatihan
12.	<i>Rubber cleaning</i>	<i>Compression grade rubber sheet</i>	2	Shot	Per peserta pelatihan
13.	<i>Rubber wax</i>	<i>Compression grade rubber sheet</i>	2	Shot	Per peserta pelatihan
14.	<i>Melamine cleaning</i>	<i>Pellet type</i>	2	Shot	Per peserta pelatihan
15.	<i>Mold compound</i>	Menyesuaikan dengan <i>package</i> yang akan di buat	2	Shot	Per peserta pelatihan
16.					

F. DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN

NO	NAMA	PROFESI
1.	Ida Bagus Ngesti Dewa Manuaba	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia (PPISI)
2.	Dadang Sucahya	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia (PPISI)
3.	Rahmat Daryono	Excelitas
4.	Denny Oscar	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia (PPISI)
5.	Junaidi	Excelitas
6.	Didik Eko S	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia (PPISI)
7.	Tri Wicaksono	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia (PPISI)
8.	Mustanir	Infineon Technologies Batam
9.	Joko Priyono	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia (PPISI)
10.	H.A. Irminda Netty Wahyuningsih	LPK Duta Teknologi
11.	Eli Wulandari	PT. PCI Elektronik Internasional
12.	M. Arifin	Politeknik Negeri Batam